

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该内容而引致之任何损失承担任何责任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯国际集成电路制造有限公司*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号：0981)

中芯截至二零零四年三月三十一日止三个月业绩公布

- 本公司于今日公布截至二零零四年三月三十一日止三个月的未经审核经营业绩。销售额由上季的145,000,000元增至二零零四年首季的186,900,000元，增幅28.9%。经营溢利由上季的4,600,000元增至二零零四年首季的26,800,000元，增幅481.3%。毛利率由上季的21.2%增至二零零四年首季的32.2%。
- 以下为本公司于二零零四年四月二十六日就截至二零零四年三月三十一日止三个月的未经审核业绩在美国报章所作的报章公布全文。
- 由于本公司于二零零四年四月二十六日在美国作出报章公布(现转载如下)，因此根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(1)条及上市协议第2(1)段规定的披露责任而作出本公布。

以下为本公司于二零零四年四月二十六日就截至二零零四年三月三十一日止三个月的未经审核业绩在美国报章所作的报章公布全文。

所有货币数字均以美元列账。

报告内的财务报表数额按美国公认会计准则厘定。

中芯二零零四年首季业绩报告

概要

- 销售额增至186,900,000元，较二零零三年第四季度上升28.9%。
- 经营溢利增至26,800,000元，较二零零三年第四季度上升481.3%。
- 收入净额增至27,500,000元，较二零零三年第四季度上升152.4%。
- 晶圆付运增加13.8%至174,325片8吋等值晶圆；综合平均售价上升10.8%至1,008元。
- 本公司同时于纽约证券交易所及香港联交所顺利完成首次公开招股，成功集资1,017,000,000元。

中国上海—二零零四年四月二十六日—国际主要半导体承包商制造中芯国际集成电路制造有限公司(纽约交易所：SMI；香港联交所：981)(中芯或[本公司])于今日公布截至二零零四年三月三十一日止三个月的综合经营业绩。二零零四年首季销售额由上一季度的145,000,000元增加28.9%至186,900,000元。二零零四年首季经营溢利由上一季度的4,600,000元增加481.3%至26,800,000元。二零零四年首季经常性净收入由上一季度的10,900,000元增加152.4%至27,500,000元。二零零四年首季毛利率由上一季度的21.2%上升至32.2%。

本公司报告普通股持有人应占净收入为8,600,000元，相当于每股0.0033元及每股美国预托股份0.1630元(按全面摊薄基准计算则为每股0.0005元及每股美国预托股份0.0273元)。扣除一项为数18,000,000元的一次性非现金优先股未发股息，经常性净收入应为27,500,000元，相当于每股0.0104元及每股美国预托股份0.5197元(按全面摊薄基准计算则为每股0.0017元及每股美国预托股份0.0869元)。

「我们很高兴二零零四年首季业绩持续录得增长，中芯主席兼行政总裁张汝京博士表示，「本季度，本公司经营业绩取得重大增长，有赖「产能加紧令付运晶圆数量增多，透过采纳更先进的制程而在产品组合中加入更多定价较高的晶圆产品，使平均销售价格不断提升，以及整体市场环境积极向好。二零零四年首季期间，我们新增十六名客户，并从所有市场类别的客户接获数量庞大的订单，其中尤以通讯市场类别为然。本公司首季业绩表现，包括在二零零四年三月十八日同时于纽约证券交易所及香港联交所顺利完成首次公开招股，成功集资共1,017,000,000元，足以证明我们的业务计划行之有效，在承包商制造业具有高度竞争力。」

电话会议／网上业绩公布详情

日期：二零零四年四月二十六日
时间：上海时间晚上八时正
拨号及登入密码：美国1-617-801-9715(密码：32233010)或香港852-800-963-844(密码：32233010)。

二零零四年首季业绩公布网上直播可于www.smics.com网站「投资者关系」一栏收听。中芯网站在网上广播后为两二个月提供网上广播录音版本连本网站发布的载拷贝。

有关中芯

中芯(纽约交易所：SMI；香港联交所：0981.HK)是全球首屈一指的半导体承包商制造厂之一。作为一家半导体承包商制造厂，中芯提供以0.35微米至0.13微米技术制造的集成电路。中芯成立于二零零零年四月，是一家开曼群岛公司，于中国上海张江高科技园区营运三间8吋晶圆厂(装配)，以及于天津营运一间0.18微米厂(装配)。此外，中芯现正在中国北京兴建一座12吋晶圆厂(装配)。二零零三年五月，中芯一获同业主要刊物《半导体国际杂志》为「二零零三年年度最佳半导体厂」。除制造集成电路以外，中芯亦为客户提供一应俱全的服务，包括设计服务、光罩制造及晶圆探测测试等。其他资料详情，请浏览www.smics.com。

安全港声明

(根据1995年人权有价证券诉讼改革法案)

本次新闻发布可能载有(除历史资料外)依据1995年人权有价证券诉讼改革法案所界定的「前瞻性陈述」。该等前瞻性陈述乃根据中芯对未来事件的现行预期、期望及预测而作出。中芯使用「相信」、「预期」、「计划」、「估计」、「预测」、「预期」及类似表述为该等前瞻性陈述之标识，为并非所有前瞻性陈述均包含上述字眼。该等前瞻性陈述乃反映中芯高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大未知及未知风险、不确定性，以及其他可能导致中芯实际业绩、财政状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料存在重大差异的因素，包括但不限于与半导体行业周期及市场状况有关的风险、激烈竞争、中芯客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯晶圆厂产品的能力、半导体承包商提供服务所需之市场、市场产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造业生产周期及最终市场的金融局势是否稳定。

投资者应考虑中芯关于美国证券交易委员会(「证监会」)的文件资料，包括其于二零零四年三月十一日以F-1表格(经修订)形式提交予证监会的登记声明，特别是「风险因素」及「有关财政状况及经营业绩的管理层讨论及分析」两个部份。其于二零零四年三月八日以A-I表格形式提交予香港联合交易所(「香港联交所」)的登记声明，以及中芯可能不时向证监会及香港联交所提交的该等其他文件，包括「A表格」。其他未知或不可预料的因素亦可能会对中芯日后的业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于上述风险、不确定性、假设及假设，本新闻发布中提及的前瞻性事件可能不会发生。务请阁下注意，切勿勿倚赖此等前瞻性陈述，此等陈述仅就本新闻发布中所载述日期(或如无其他日期，则本新闻发布日期)的情况而表述。

除法律有所规定以外，中芯概不就因新资料、未来事件或其他原因引起的任何情况承担任何责任，亦不拟更新任何前瞻性陈述。

投资者联络资料：

Jimmy Lai
投资者关系部
电话：86-21-5080-2000，内线16088
传真：86-21-5080-3070

Evonne Hwang
投资者关系部
电话：86-21-5080-2000，内线16275
传真：86-21-5080-3070

概要：
以千美元为单位(每股盈利除外)

	二零零四年首季	二零零三年第四季	季度比较	二零零三年首季	年度比较
销售	186,937	145,047	28.9%	38,442	386.3%
毛利	60,156	30,714	95.9%	(25,053)	—
经营开支	(33,313)	(26,097)	(27.7%)	(13,279)	150.9%
经营溢利	26,845	4,617	481.3%	(38,332)	—
其他收入	609	6,260	(90.3%)	2,900	117.5%
收入净额 ⁽¹⁾	27,452	10,877	152.4%	(38,052)	—
未发股息 ⁽²⁾	(18,839)	(2,531)	644.4%	0	—
普通股持有人应占净利润	8,613	8,346	3.2%	(38,052)	—
毛利率	32.2%	21.2%		(65.2%)	
经营利润率	14.4%	3.2%		(99.7%)	
每股基本盈利—每股普通股 ⁽³⁾	\$0.0033	\$0.0867		\$(0.4434)	
每股基本盈利—每股美国预托股份 ⁽⁴⁾	\$0.1630	\$4.3334		\$(22.1718)	
每股摊薄盈利—每股普通股 ⁽⁵⁾	\$0.0005	\$0.0005		\$(0.4434)	
每股摊薄盈利—每股美国预托股份 ⁽⁶⁾	\$0.0273	\$0.0268		\$(22.1718)	
付运晶圆(千片8吋等值) ⁽⁷⁾	174,325	153,125	13.8%	74,596	133.7%
综合平均售价	\$1,008	\$910	10.8%	\$494	104.0%
逻辑平均售价 ⁽⁸⁾	\$1,081	\$967	11.8%	\$635	70.2%
产能使用率	99%	97%		88%	

- 附注：
- 未扣除18,800,000元未发股息前。
 - 按二零零四年首季不包括股息后的净收入计算，每股普通股基本盈利为0.0104元。二零零三年第四季每股普通股基本盈利为0.1130元。
 - 按二零零四年首季不包括股息后的净收入计算，每股美国预托股份基本盈利为70.5197元。二零零三年第四季每股美国预托股份基本盈利为5.6840元。
 - 按二零零四年首季不包括股息后的净收入计算，每股普通股摊薄盈利为0.0017元。二零零三年第四季每股普通股摊薄盈利为0.0007元。
 - 按二零零四年首季不包括股息后的净收入计算，每股美国预托股份摊薄盈利为0.0869元。二零零三年第四季每股美国预托股份摊薄盈利为0.0349元。
 - 包括铜连接件
 - 不包括铜连接件
 - 销售额增至186,900,000元，较二零零三年第四季度的145,000,000元录得季度升幅28.9%，并较二零零三年首季的38,400,000元录得年度升幅386.3%。导致此上升的主要因素如下：
 - 二零零四年首季产能增加至65,420片8吋晶圆；
 - 晶圆付运增至174,325片，较二零零三年第四季度的153,125片录得季度升幅13.8%；
 - 使用率升至99%；及
 - 透过在产品组合中加入更多定价较高的晶圆产品，平均售价上升至1,008元，较二零零三年第四季度的910元上升10.8%。

- 毛利增至60,200,000元，较二零零三年第四季度的30,700,000元录得季度升幅95.9%，二零零三年首季则为(25,100,000)元。毛利率由二零零三年第四季度的21.2%上升至二零零四年首季的32.2%。
- 研发费用增加至16,500,000元，较上季的9,300,000元上升77.1%，主要来自天津七厂的非经常性开业成本。
- 一般行政费用从12,300,000元减少12.8%至10,700,000元，主要因外汇变动所致。
- 销售及市场推广费用从2,300,000元减少23.0%至1,700,000元。
- 经营溢利增至26,800,000元，较二零零三年第四季度的4,600,000元录得季度升幅481.3%，二零零三年首季则为(38,300,000)元。
- 二零零四年首季利息收入减少1,500,000元，主要因二零零三年第四季度就本公司出售C系列可转换优先股而收取非经常性利息款项。二零零四年首季利息支出因资本化利息金额减少而增加1,800,000元。
- 净收入增至27,500,000元，较二零零三年第四季度的10,900,000元录得季度升幅152.4%，二零零三年首季则为(38,100,000)元。普通股持有人应占净收入增至8,600,000元，较二零零三年第四季度的8,300,000元录得季度升幅3.2%，二零零三年首季则为(38,100,000)元。

1. 收入分析

销售分析	二零零四年首季	二零零三年第四季	二零零三年第三季	二零零三年第二季	二零零三年第一季
以应用分类					
电脑	25.1%	26.7%	33.3%	49.8%	71.6%
通讯	56.0%	55.8%	48.2%	32.5%	14.5%
其他	6.2%	4.0%	6.8%	6.4%	4.2%
以技术分类(仅包括逻辑、记忆及铜连接件)					
0.13µm	10.1%	10.4%	15.0%	13.5%	4.6%
0.15µm	15.7%	17.5%	10.0%	0.0%	0.0%
0.18µm	44.4%	34.7%	19.7%	10.5%	2.7%
0.25µm	8.3%	10.6%	33.7%	57.4%	82.5%
0.35µm	21.5%	26.8%	21.6%	18.6%	10.2%
以逻辑分类 ⁽¹⁾					
0.13µm	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.15µm	4.4%	1.9%	0.3%	0.1%	0.0%
0.18µm	58.5%	52.9%	40.3%	33.3%	13.7%
0.25µm	5.0%	3.4%	15.1%	7.6%	35.5%
0.35µm	32.1%	41.8%	44.3%	59.0%	50.8%
以装置分类					
逻辑(仅包括铜连接件)	72.4%	71.6%	60.0%	43.3%	23.6%
记忆体	21.6%	24.5%	34.0%	53.0%	72.2%
其他(光罩制造及探测)	6.0%	3.9%	6.0%	3.7%	4.2%
以客户类别分类					
非厂房半导体公司	36.6%	30.8%	31.1%	38.2%	48.9%
集成装置制造商	54.0%	62.7%	49.2%	29.9%	8.2%
系统及其他	9.4%	6.5%	19.7%	31.9%	42.9%
以地区分类					
北美洲	41.4%	36.2%	38.8%	39.6%	26.6%
欧洲	13.3%	9.5%	24.8%	42.1%	67.2%
亚洲	12.2%	17.7%	11.4%	10.4%	0.7%
日本	16.3%	15.5%	13.3%	4.2%	2.7%
欧洲	15.1%	19.7%	9.7%	1.6%	0.1%
亚太区(不包括日本、南韓及台湾)	1.7%	1.4%	2.0%	2.1%	2.7%

- 附注：
- 不包括0.13µm铜连接件
 - 相较二零零三年第四季度而言，二零零四年首季通讯类的销售额较其他应用技术增长更快。
 - 二零零四年首季逻辑晶圆(包括铜连接件)的销售百分比上升至占销售额达72.4%，二零零三年第四季度及二零零三年第一季度则分别为71.6%及73.6%。
 - 二零零四年首季0.18µm及以下技术的销售百分比上升至占销售额达70.2%，二零零三年第四季度及二零零三年第一季度则分别为76.2%及73.3%。
 - 非厂房公司占二零零四年首季销售额36.6%，二零零三年第四季度则占30.8%。
 - 二零零四年首季源自北美洲客户的销售百分比上升至41.4%，二零零三年第四季度则为36.2%，二零零四年首季源自台湾及日本客户的销售百分比分别上升至13.3%及16.3%，二零零三年第四季度则分别为9.5%及15.5%。

产能：	二零零四年首季	二零零三年第四季			
期终每月晶圆计，8吋等值					
厂/（晶圆尺寸）					
一厂(8吋)	31,720	28,000			
二厂(8吋)	24,400	21,000			
每月晶圆装配总产能	56,120	49,000			
铜连接件：					
每月铜连接件总产能	9,300	9,000			
* 截至二零零四年首季度结束时，由于本公司不断提升一、二及三厂的冲次表现，每月产能增加至65,420件晶圆					
付运及使用率：					
8吋晶圆	二零零四年首季	二零零三年第四季	二零零三年第三季	二零零三年第二季	二零零三年第一季
付运晶圆(包括铜连接件)	174,325	153,125	130,780	117,950	74,596
使用率(1)	99%	97%	93%	97%	88%

附注：

(1) 使用率按除晶圆总额除以估计产能计算

• 二零零四年首季晶圆付运量为174,325件8吋晶圆，分别较二零零三年第四季度及二零零三年第一季度上升13.8%及133.7%。

• 使用率因应每季产能冲次表现及产品组合而变化。



二零零四年首季综合平均售价分别由二零零三年第四季度及二零零三年第一季度分别由1,081元及967元上升至1,008元。主要原因在于本公司转而生产更多逻辑产品，减产DRAM晶圆、采纳更先进及更高利润的处理技术。半导体产品市场价格整体上升以及本公司的市场地位。

二零零四年首季逻辑平均售价(不包括0.13µm铜连接件)分别由二零零三年第四季度及二零零三年第一季度分别由1,081元及967元上升至1,008元。主要原因在于本公司转而生产更多逻辑产品，减产DRAM晶圆、采纳更先进及更高利润的处理技术。半导体产品市场价格整体上升以及本公司的市场地位。

2. 详细财务分析

毛利分析	二零零四年首季	二零零三年第四季	季度比较	二零零三年首季	年度比较
以千美元计					
销售成本	126,781	114,333	10.9%	63,495	99.7%
折旧	64,423	58,193	10.7%	28,511	126.0%
其他制造成本	62,538	56,140	11.1%	34,984	78.2%
毛利	60,156	30,714	95.9%	(25,053)	—
毛利率	32.2%	21.2%		(65.2%)	

• 毛利增至60,200,000元，较二零零三年第四季度的30,700,000元录得季度升幅95.9%，二零零三年首季则为(25,100,000)元，录得升幅主要由于晶圆付运增加以致产能提升、使用率上升，以及透过在产品组合中加入更多定价较高的晶圆产品，使平均销售价格上升。

• 毛利率由二零零三年第四季度的21.2%上升至二零零四年首季的32.2%。

经营开支分析

以千美元计	二零零四年首季	二零零三年第四季	季度比较	二零零三年首季	年度比较
总经营开支	(33,313)	(26,097)	27.7%	(13,279)	150.9%
一般及行政	(10,688)	(12,251)	(12.8%)	(3,916)	172.9%
销售及市场推广	(1,747)	(2,270)	(23.0%)	(2,145)	(18.6%)
研究及开发	(16,540)	(9,341)	77.1%	(6,339)	160.9%
递延股份报酬摊销	(4,338)	(2,235)	94.1%	(879)	393.5%

• 总经营开支增至33,300,000元，较二零零三年第四季度的26,100,000元录得季度升幅27.7%，并较二零零三年首季的13,300,000元录得年度升幅150.9%。

• 研究及开发费用增至16,500,000元，较上季的9,300,000元录得季度升幅77.1%，主要来自天津七厂的非经常性开业成本。

• 递延股份报酬摊销增至4,300,000元，较上季的2,200,000元录得季度升幅94.1%，主要因就完成收购七厂向雇员发行购股权所致。

非经营项目

以千美元计	二零零四年首季	二零零三年第四季	季度比较	二零零三年首季	年度比较
其他收入，净额	609	6,260	(90.3%)	280	117.5%
利息收入	1,484	2,983	(50.3%)	678	118.9%
利息支出，扣除政府补贴	(2,743)	(926)	196.4%	(146)	1777.9%
其他，净额	1,868	4,203	(55.5%)	(252)	—
未发股息	(18,839)	(2,531)	(644.4%)	0	—

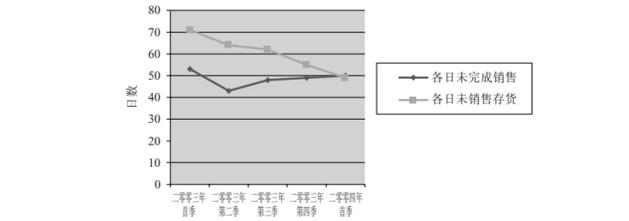
• 二零零四年首季利息收入减少1,500,000元，主要因二零零三年第四季度就本公司出售C系列可转换优先股而收取非经常性利息款项。二零零四年首季利息支出因资本化利息金额减少而增加1,800,000元。

• 属非现金及非经常性开支项目的未发股息，指可购买本公司于二零零四年首季首次发行D系列可转换优先股的认股权证溢价及换股价与其各自市价的差额。有关认股权证已于本公司首次公开招股结束时届满。

3. 流动资金

	二零零四年首季	二零零三年第四季
以百万计		
现金及现金等价物	1,373,072	445,276
短期投资	27,306	27,165
应收账款	116,812	90,539
存货	85,479	69,924
其他	50,383	47,978
总流动资产	1,653,052	680,882
应付账款	390,071	211,762
长期借款的即期部份	95,992	0
其他	88,951	113,669
总流动负债	575,014	325,431
现金比率	2.4x	1.4x
流动比率	2.7x	2.1x
流动比率	2.9x	2.1x
• 现金及现金等价物由445,300,000元增至1,373,100,000元，主要由于收到首次公开发售所得款项净额。现金比率为2.4倍，仍处于稳健状况。		

应收账款/存货的各日走势



• 存货流转持续有所改善，未销售存货的日数由二零零三年第四季的55日减至二零零四年首季的49日。

股本结构	二零零四年首季	二零零三年第四季
以百万计		
现金及现金等价物	1,373,072	445,276
短期投资	27,306	27,165
长期借款的即期部份	95,992	0
长期借款	397,898	479,961
总借款	493,890	479,961
现金净额	906,488	(7,520)
股东权益	2,894,431	1,485,115
总借款对权益比率	17.1%	32.3%
• 总借款由二零零三年第四季的480,000,000元增至二零零四年首季的493,900,000元。		
• 总借款对权益比率由二零零三年第四季的32.3%改善至二零零四年首季的17.1%。		

4. 现金流量及资本开支

以百万计	二零零四年首季	二零零三年第四季
收入净额	27,452	10,877
折旧及摊销	84,264	68,898
所购无形资产摊销	3,237	1,041
现金变动净额	927,796	(33,597)

• 计划下的二零零四年资本开支仍为1,950,000,000元。

5. 二零零四年第二季展望及指引

- 晶圆付运预期增加约15%
- 使用率仍处于相若水平
- 按季度比较下综合ASP并无变动
- 逻辑程序混合为0.18µm及以下，不包括铜连接件，应维持在相若水平
- 逻辑及记忆体产品收入仍处于相若水平
- 毛利率约为25%，这是由于第七厂发展所涉及的折旧支出所致。不计该等折旧支出，毛利率应稍高于30%
- 经营开支相对销售的百分比应维持于目前水平
- 资本开支约为800,000,000元
- 折旧及摊销约为100,000,000元至110,000,000元
- 递延补偿开支约为7,000,000元，其中约4,000,000元将于经营开支中扣减及销售成本为3,000,000元

6. 近期公布

- 市场稳定措施及稳定措施期结束(二零零四年四月十六日)
- 中芯提升IP Portfolio With Artisan的0